



2026 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名	A I メカテック株式会社
代表者名	代表取締役執行役員社長 阿部 猪佐雄 (コード番号: 6227 東証スタンダード)
問合せ先	執行役員経営企画部長 米田 達也 (TEL 0297-62-9122)

A I 用先端半導体パッケージ向けはんだボールマウンタシステム受注のお知らせ

当社は、海外の大手半導体関連メーカーより、はんだボールマウンタシステムを複数ライン受注いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 今回の受注について

はんだボールマウンタは、半導体パッケージの組立工程に用いられる装置ですが、今回の受注は、半導体パッケージの中でも特にデータセンター向けA I 用先端半導体パッケージ用途となります。A I 用先端半導体の需要拡大に伴い、海外の大手半導体関連メーカーが、生産能力増強のためはんだボールマウンタシステムの複数ラインの増設を行うことが背景にあります。

A I 用先端半導体パッケージの組立工程では、高い安定性と優れた歩留まりが求められています。当社は、ボールマウント技術をはじめ、数多くの量産設備で培ってきたシステムインテグレーション技術を結集した、新型はんだボールマウンタシステムの提案をしてまいりました。その結果、お客様の要求に応える高い安定性と生産性を実現するソリューションとして高く評価され、今般の受注に至りました。

2. 受注内容

受注製品	はんだボールマウンタシステム
受注金額	約 25 億円
売上計上予定	2028 年 6 月期

3. 業績への影響

当該受注は、2028 年 6 月期に売上計上する見込みです。なお、顧客との納期調整等により、2026 年 8 月 7 日公表予定の 2027 年 6 月期の連結業績予想に修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。

なお、当該受注はすべて円建てとなっており、為替レートの変動による影響はありません。

以 上